

2026年度 大阪公立大学 半導体デバイスプロセス技術基礎講座

於:大阪公立大学 i-siteなんば および オンライン



主催 大阪公立大学 協創研究センター
半導体超加工・集積化技術研究所

第1回	4月6日	AI社会と経済構造変革時代の半導体市場	岸本 隆正 氏	(株)野村総合研究所【講師変更】
第2回	5月12日	めっき技術の基礎と応用	藤原 裕 氏	元(地独)大阪産業技術研究所
第3回	6月9日	異種相界面と接着現象	田中 敬二 教授	九州大学 工学研究院
第4回	6月23日	スパッタリング成膜の基礎および最近の応用	恒川 孝二 氏	キヤノンアネルバ(株)
第5回	7月14日	ガラスサブストレート、パネルレベルパッケージの基礎と応用展開	八甫谷 明彦 教授	東北大学【講師変更】
第6回	8月4日	最先端半導体デバイスBig3の前工程プロセス・デバイス技術とその展望 (仮)	廣田 良浩 氏	ワイドヴィル
第7回	9月1日	半導体の信頼性各論 (仮)	菊田邦子 氏	グローバル・テック・プラン(株)
第8回	9月29日	半導体支持基板の基礎と最新状況 (仮)	片桐 規貴 氏	新光電気工業(株)
10月～2027年3月に、第9回～第16回、特別講演会 1 回を開催予定				

- ・ セミナー(C1講義室* *4/6はC2講義室、9/1はC3講義室) : 15時30分～18時20分
- ・ 名刺交換会 (A1/A2講義室) : 18時30分～ (1時間程度)

日程、内容は変更されることがございます